174

高透明度灌封胶

用　　途：		电子零件灌封或披覆。
颜　　色：		透明
比　　重：		1.07
混合比(重量比)：		100：35
黏　　度：	@23℃	600 CPS
可操作时间：	@23℃	约2 hrs (100G)
硬化时间：	@23℃	16 hrs
	@80℃	1 hrs
线性收缩：		0.008 in/in
硬　　度：		80 Shore D
热传导系数：		8.0×10^{-4} cal×cm/sec×cm×℃
重量损耗率：	@175℃	168 hrs　1.5%
重量增加率：	@25℃	2 hrs　0.19%
		24hrs　0.05%
体积电阻：	@23℃	5.0×10^{15} ohm/cm
消散因素：	@23℃	1000 cycles 0.0031
绝缘常数：	@23℃	1000 cycles 3.6
绝缘强度：	@23℃	550 VPM (21.7 kV/mm)
保存期限：	@23℃	一年以上

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707 jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 · FAX：021-58356976